

镀金微电子封装热沉材料生产厂家封装外壳箱体芯片

产品名称	镀金微电子封装热沉材料生产厂家封装外壳箱体芯片
公司名称	陕西欣龙金属机电有限公司
价格	1.00/件
规格参数	名词:电子封装及热沉材料 常用材质:钨铜合金, 钼铜合金 其他材质:铜-钼-铜CMC, 铜-钼铜-铜 Cu/MoCu/Cu, 多层式铜-钼-铜S-CMC
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市经济开发区
联系电话	029-82127495 13991390727

产品详情

热沉材料

功率电子器件和电路在运行时会产生大量的热。热沉材料有助于消除芯片热量，将其传输到其他介质，维持芯片稳定工作。

钼铜、钨铜、铜-钼-铜（CMC）、铜-钼铜-铜（Cu/MoCu/Cu）和多层式铜-钼-铜（S-CMC）材料结合了钼、钨的低热膨胀率和铜的高热导率，可有效释放电子器件的热量，有助于冷却IGBT模块、热控板、热沉材料和引线框架。

我们可以按照客户的要求提供以上各种材料的板材和成品。如有需要，也可以提供镀镍、镀金产品。

手机：(86)13991390727 赵女士

微信：sxxljs

QQ：1450014646

原料（名称）	成分[wt%]	20 ° C时密度[g/cm ³]	RT ~ 400 ° C时热膨胀系数[10 ⁻⁶ /K]	20 ° C时热导率 [W/(m · K)]
MoCu30	Mo-30% Cu	9.7 ± 0.2	8.3	190
WCu10	W-10% Cu	17.1 ± 0.4	7.2	160
WCu15	W-15% Cu	16.8 ± 0.4	7.2	170

WCu20	W-20% Cu	15.6 ± 0.4	8.5	180
Cu/Mo-30Cu/Cu (C PC)	1:4:1 /Mo-52%Cu	9.4 ± 0.2	7.2-9	340 (平面) 300 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:1:1 /Mo-66%Cu	9.3 ± 0.2	8.8	305 (平面) 250 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:2:1 /Mo-50%Cu	9.54 ± 0.2	7.8	260 (平面) 210 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:3:1 /Mo-40%Cu	9.66 ± 0.2	6.8	244 (平面) 190 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:4:1 /Mo-33%Cu	9.75 ± 0.2	6.0	220 (平面) 180 (厚度)
无氧铜TU1		8.93	17.7	391

陕西欣龙金属机电有限公司主要经营业务涉及航空、航天、电子、核工业、船舶工业、兵器、光电、石化、燃气等行业相关的专用材料及设备的供应合作领域。成立多年来，以诚实守信的经营理念服务社会，赢得了广大客户的好评。（电子元器件封装，电子元件封装，微电子封装技术，电子封装，电子元器件材料，微电子封装热沉片）并取得了良好的业绩。公司主要经营项目为：精密合金、高温合金、钛合金、难熔及稀贵金属、特殊不锈钢材料及特殊用途合金的开发与研制。并代理美国wall colmonoy的镍基钎料及经销国内各类钎料（是美国wall colmonoy公司在中国西北区域的代理商）。

我们一直遵循和倡导迅捷、优质的服务精神。近十年来，公司切实而有效地为客户解决了军工及民用产品生产和研发过程中高、精、尖材料需求所存在的急、偏、少等实际困难。（电子封装热沉，电子封装技术，电子封装材料）

我公司是专业生产和经营精密合金、高温合金、特殊钢、稀贵金属、难熔金属等方面金属材料的一般纳税人企业。依托于西安相关的生产企业，科研院所雄厚的技术实力和装备优势。充分考虑到此类产品需求少，品种多的特点，为您提供最贴切的服务。同时还为使用单位研制和开发新材料，解决各类疑难材料。（微电子封装钨铜片，钨铜封装热沉片生产厂家，钨铜封装热沉材料，镀金微电子封装片，镀金微波器件封装外壳生产厂家，镀金钨铜电子封装热沉片，镀金钼铜电子封装热沉片）

我公司将以优良的品质，极具竞争力的价格，快捷的供货方式和周到的服务向国内外新老朋友提供各种优质的产品。真诚地欢迎您的垂询，欣龙金属将成为您最值得信任的合作伙伴！（镀金微电子封装热沉片，镀金集成电路器件封装外壳，镀金电子封装热沉材料，镀金钨铜合金，镀金钼铜合金）

主营产品 精密合金，高温合金，钛合金，钎料，稀金属材料，钨，钨钼合金，钼，钨铜合金，钼铜合金，钨基高比重，电子封装及热沉材料，氩弧焊用钨电极，软磁合金，永磁合金，弹性合金，膨胀合金，不锈钢，热双金属带材，镍合金，钽铌合金，高电阻电热合金，高温耐蚀合金，软磁铁芯。

有色金属原材料价格时常波动，所以本产品价格仅供参考。您可以通过电话联系询价或者在本公司阿里巴巴店铺询问。 <https://sxxljjsjd.1688.com/?spm=a2615.7691473.0.0.BdYmIR>